

半导体行业合规

Semiconductor Industry Compliance

半月刊 (5月第2期, 2021年总第10期)

贸易合规 经济制裁 海外投资
立法动态 业界动态



目 录

一、 贸易合规/经济制裁.....	1
(一) 美国财政部发布与中共涉军企业清单有关的通用许可证	
1B 1	
(二) 高云半导体起诉美国国防部和财政部	2
二、 海外投资	2
(三) SK Hynix 收购 NAND 业务获得欧盟批准	2
(四) 赴港上市盈利要求提高	3
三、 立法动态	4
(五) 中欧投资协议暂停执行	4
四、 业界动态	5
(六) 台积电称 1 纳米以下制程取得重大突破	5
(七) 韩国四大企业集团发布 394 亿美元对美投资计划	5
(八) 日本计划促成台积电在日本建厂	6
(九) 美国计划新建 7 到 10 家晶圆厂	6
(十) 美国商务部长与 SIA 进行会晤	7

(十一) 美国的半导体激励措施将平均每年为美国创造近 20 万个就业机会8

一、 贸易合规/经济制裁

(一) 美国财政部发布与中共涉军企业清单有关的通用许可证 1Bⁱ

当地时间 5 月 18 日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC) 发布通用许可证 1B，在 2021 年 6 月 11 日东部时间上午 9:30 之前，授权可以进行被行政令 13959 号所禁止的、涉及某些与行政令 13959 号所指定的“中共涉军企业”非常接近但不完全匹配的实体的公开证券交易（或其衍生品或为此类证券提供投资机会的其他证券）的交易或活动。

但就根据行政令 13959 号列入“非 SDN 涉军企业清单”(Non-SDN Communist Chinese Military Company List)的实体子公司，通用许可证 1B 并不授权进行任何涉及该等实体的公开证券交易（或其衍生品或为此类证券提供投资机会的其他证券）的交易或活动。

通用许可证 1B 取代了 1 月 26 日发布的通用许可 1A 号，自 5 月 18 日生效。换言之，美国将对中共涉军企业的投资禁令再次延长了两周至 6 月 11 日。

(二) 高云半导体起诉美国国防部和财政部ⁱⁱ

据彭博社报道，广东高云半导体科技股份有限公司于 5 月 21 日在美国哥伦比亚特区联邦地区法院就美国国防部将其列入中共涉军企业清单提起诉讼。同时被列为被告的，还包括美国财政部、美国国防部部长、美国财政部部长和美国总统拜登。

高云半导体于今年 1 月 14 日被美国国防部列入中共涉军企业清单。而高云半导体也成立继小米、箩筐技术以后第三家就中共涉军企业清单起诉国防部的中国公司。而小米和箩筐技术都自法院获得了临时禁令，禁止行政令 13959 号对其生效。小米还与美国国防部达成了和解，被从中共涉军企业清单中移出。



二、 海外投资

(三) SK Hynix 收购 NAND 业务获得欧盟批准ⁱⁱⁱ

5 月 21 日，SK Hynix 发布公告，称其收购英特尔 NAND 闪存和 SSD 业务的交易获得了欧洲联盟委员会的无条件批准（不附加任何条件且无需进行进一步审查）。这是继去年美国联邦贸易委员会和今年 3 月美国外国投资委员会的批准后，该交易获得的又一份许可。

此项交易将有助于 SK Hynix 扩大其全球业务网络，强化存储技术。SK Hynix 和英特尔将尽最大努力在 2021 年取得其余所有批准。

(四) 赴港上市盈利要求提高^{iv}

香港交易所（“港交所”）于 5 月 20 日公布了有关主板上市盈利规定的咨询总结，决定从 2022 年 1 月 1 日起提高主板的盈利要求，并修订盈利部分规定，具体如下：

- 最近一个财务年度不低于 3500 万港币；
- 前两个财务年度不低于 4500 万港币（三年累计盈利不低于 8000 万港币）。

这个调增的幅度是 60%，在调整之前，主板的盈利要求是三年累计盈利不低于 5000 万港币，最近一年不低于 2000 万港币，前两个财务年度不低于 3000 万港币。

之所以调高主板盈利要求，港交所认为，主要是盈利规定从 1994 年推出之后就没有应经济和市场发展做出任何修订，另一方面市值规定（上市的最低市值要求）从 1989 年推出至今调高了 5 倍，最近一次调高是 2018 年，最低市值要求是 5 亿港币，但当时没有调整盈利要求。

港交所提高盈利要求，影响比较大的是传统中小企业。而对于新经济企业，还是可以选择非盈利的上市适用标准，比如市值/收入标准（上市前最近一个财务年度营业收入 5 亿港币以上且上市时的市值不低于 40 亿港币）以及市值/收入/现金流标准（上市前最近一个财务年度营业收入 5 亿港币以上，拟上市业务现金流入前三个财务年度合计 1 亿港币以上，上市时市值不低于 20 亿港币）。

三、 立法动态

(五) 中欧投资协议暂停执行^v

当地时间 5 月 20 日，欧洲议会就中欧投资协议进行了一项投票，决定冻结这项协议。

中欧投资协定于去年底宣布完成谈判（详见本半月刊 2021 年 1 月第 1 期）。根据原定时间表，欧洲议会应当在今年年底前完成对协议文本的审议工作，并在 2022 年予以批准通过。

而此次投票后的决议指出，由于中方对欧盟政治和外交人员的制裁措施，有理由暂停对中欧投资协议的审议程序，并称欧盟与中国的关系可能有所改变。

该决议还要求中国能批准联合国国际劳工组织的禁止强迫劳动的相关规定，以及联合国公民与政治权利国际公约。

其实，早在两周前，欧盟就曾对外界透露，投资协议的审议程序事实上已经搁置。

中国外交部则在 5 月 19 日表示，“中欧投资协议是一份平衡、互利共赢的协议，不是一方给予另一方的恩赐，是互利互惠的。尽早批准符合中欧双方利益，双方均应为此作出积极努力。”

四、 业界动态

(六) 台积电称 1 纳米以下制程取得重大突破^{vi}

5 月 18 日，台积电联合台湾大学和麻省理工宣布，在 1 纳米以下芯片方面取得重大突破，相关研究结果已经发表于 Nature 杂志。

在相关研究成果中，三家机构首次提出利用半金属铋 Bi 作为二维材料的接触电极，它可以大幅降低电阻并提高电流，使其性能媲美硅材料。在三个合作方中，麻省理工是半金属铋 Bi 电极发现者，台积电将铋沉积制程进行优化，而台大则运用氦离子束微影系统(Helium-ion beam lithography)将元件通道缩小至纳米尺寸，从而实现了这一重大突破。

(七) 韩国四大企业集团发布 394 亿美元对美投资计划^{vii}

在韩国总统文在寅访问美国期间，韩国公司透露了计划投资 394 亿美元在美国生产高科技产品。

美国当地时间 5 月 21 日双方最高领导人会晤前，在两国政府安排的会谈中，韩国相关企业的高管宣布了这一消息。三星电子表示将花费 170 亿美元建立一个新的晶圆代工厂，现代汽车承诺投资 74 亿美元扩大电动汽车生产和充电基础设施。而 LG 表示将投入 140 亿美元，在当地成立合资公司或单独投资。SK Hynix 计划投入 10 亿美元设立新兴产业研发中心。

韩国强调支持拜登政府重建供应链以及减少对中国公司依赖的努力。同时，韩方也要求美国为相关韩资企业提供税收减免和供电供水基建等配套措施。

此外，美韩两国领导人在一份联合声明中表示，他们将提高供应链的“弹性”，优先考虑半导体、电动汽车电池、制药以及战略性和关键材料等行业。

(八) 日本计划促成台积电在日本建厂^{viii}

据日本媒体《工业新闻日刊》5月26日报道，日本政府希望台积电和索尼一起投资1万亿日元（约合91.9亿美元）在日本建造首个20纳米半导体工厂。

根据消息人士所言，该项目将由日本经济产业省发起，工厂将生产用于汽车、工业机械和家用电器的芯片。

索尼发言人对于路透社表示，“这是一种推测，不予评论”。台积电则未回复要求置评的请求。

(九) 美国计划新建7到10家晶圆厂^{ix}

据路透社当地时间5月24日报道，美国商务部长Gina Raimondo表示，美国政府拟向半导体生产和研究提供520亿美元的资金，这或将建设7至10家美国新工厂。

Raimondo 是在美光科技芯片工厂外的一次活动中做出的如此表示。她预计政府基金将为芯片生产和研究带来 1500 多亿美元的投资，其中包括州政府、联邦政府和私营企业的捐款。而商务部将为颁发和使用这些资金建立一个透明的流程。

(十) 美国商务部长与 SIA 进行会晤^x

5 月 20 日，美国商务部长在听取了涉及半导体供应链和客户群的公司的首席执行官和高管的发言后，雷蒙多表示半导体在经济和国家安全中扮演着独特的角色，当半导体供应链中断时，整个经济都会受到影响。解决半导体短缺和加强国内供应链是美国商务部和拜登哈里斯政府的优先事项，进行这些对话的目的是召集一系列行业领袖，以获得更多信息，了解短缺对其行业的影响，双方可以共同解决的短期和长期解决方案，以及具体而言，政府在哪些方面最有帮助。此次谈话对商务部和行业领袖都非常有用。这些对话不仅能解决美国近期的供应短缺问题，而且能为加强美国国内长期供应链采取措施。此次对话也明确了美国就业计划 500 亿美元投资的必要性，以确保政府有能力监控供应链问题。

(十一) 美国的半导体激励措施将平均每年为美国创造近 20 万个就业机会^{xi}

根据 Oxford Economics/SIA 的研究，半导体行业目前在美国 49 个州共有 27.7 万名员工，为美国提供了 160 万个新增就业岗位。

2021 年 5 月 19 日，华盛顿半导体工业协会（SIA）与牛津经济学院（Oxford Economics）合作，并发布了一份研究报告，分析了美国半导体劳动力以及联邦政府对国内芯片生产的强劲投资将带来的经济效益。这份报告发现，半导体行业直接雇佣了 27.7 万名工人从事高薪研发、设计、生产和服务，美国 49 个州的制造业就业岗位增加了 160 万个。

这项研究还预计，一项 500 亿美元的联邦投资计划将激励国内半导体制造业，随着 2021-2026 年新的半导体制造设施或晶圆厂的建成，该计划将平均每年为美国创造 18.5 万个临时就业机会，每年为美国经济增加 246 亿美元。

该研究还发现，一项 500 亿美元的联邦投资计划刺激国内半导体制造业，除了在 2021 年至 2026 年期间推动美国临时性就业岗位的创造外，2026 年以后还将为美国经济增加 28 万个永久性就业岗位，其中包括 4.2 万个半导体行业直接就业岗位。

其他主要报告表明：

- 2020 年，半导体产业对美国经济的总影响达 2464 亿美元。

- 半导体是 300 多个下游经济部门的关键投入，占美国 2600 多万工人的比重。
- 半导体行业的工人生产率很高，工人的 2020 年平均年收入为 17 万美元。
- 该行业有五分之一的员工没有上过大学，这意味着该行业提供了重要的蓝领就业机会，在这些就业机会中，员工可以获得技能，赚取维持家庭生计的工资。
- 与美国所有行业的平均水平相比，半导体行业雇用的非白人工人比例更大。

这项研究还强调了通过强有力的联邦投资来扩大美国半导体研发、设计和制造业的迫切需要，如 2021 年 1 月颁布但尚未得到资助的《美国芯片法案》（CHIPS for America, CHIPS）所要求的投资。研究显示，通过支持国内半导体产业的扩张，几乎所有其他经济部门都将受益。这可以通过供应链支出和更大的消费支出来实现，也可以通过增加下游产业的半导体供应来实现。

此外，联邦政府在半导体研究方面的投资在 GDP 中所占份额持平，而其他国家的政府则在加强自身半导体能力的研究项目上进行了大量投资。而 SIA-波士顿咨询公司（SIA-BCG）的另一项研究显示，近年来，全球半导体供应链出现漏洞，必须通过政府在芯片制造和研究方面的投资加以解决。

集成电路知识产权联盟（ICIP Alliance）是在工业和信息化部科技司、工业和信息化部电子信息司及国家和地方相关主管部门指导下，由国家工业信息安全发展研究中心（工业和信息化部电子第一研究所，简称“国家工信安全中心”）牵头发起、于2016年1月20日正式成立的行业性、非营利性社会组织。国家集成电路产业投资基金股份有限公司为联盟名誉理事长单位，国家工信安全中心为联盟理事长单位，联盟秘书处设在国家工信安全中心-CIC 赛昇计世资讯。联盟成员覆盖集成电路设计、制造、封装、测试、相关装备和材料等产业链上下游企业及标准化、科研院所、相关软件开发、系统集成、互联网、内容与服务等企事业单位及社会团体组织，旨在整合全产业链资源，积极营造全产业链融入和适应国际竞争规则、尊重和加强知识产权保护、重视和加强合规管理的环境与氛围。

若有相关问题需要咨询或了解集成电路知识产权联盟，欢迎联系杨晓丽秘书长 65463692@qq.com 或中集知联小助手：ICIP_Alliance 或关注“中集知联”微信公众号查看更多信息。



美国奥斯顿律师事务所（Alston & Bird LLP）成立于1893年，在全球范围设有13家办公室，拥有约800多名律师，是一间面向全球的综合性国际律师事务所，为国内及跨国客户提供跨越多行业的最优法律服务。奥斯顿的国际贸易与合规团队是各大国际律所中少有的专业从事贸易合规相关业务的团队。它以美国华盛顿特区为核心辐射全球，为各类跨境商业活动提供合规咨询和法律支持，成功协助了各行业各类客户处理了各类复杂和敏感的国际贸易和法律合规事宜。依托原本就十分坚实的知识产权业务基础，半导体行业是奥斯顿国际贸易与合规团队近年来的执业重点，数年来已经为诸多业界领跑者提供了大量卓有成效的法律服务。

本半月刊中的任何内容并不构成本所的任何法律意见或建议。若对本半月刊的内容有任何问题或需要进一步了解奥斯顿律师事务所，欢迎联系李奕律师 yi.li@alston.com 或徐静婷 jing.xu@alston.com。

- ⁱ 参见: https://home.treasury.gov/system/files/126/ccmc_gl1b.pdf。
- ⁱⁱ 参见: <https://news.bloomberglaw.com/us-law-week/chinese-semiconductor-maker-challenges-military-designation>。
- ⁱⁱⁱ 参见: <https://news.skynix.com/sk-hynix-receives-clearance-for-intel-nand-and-ssd-business-acquisition-from-the-european-commission/>。
- ^{iv} 参见: https://www.hkex.com.hk/News/Regulatory-Announcements/2021/210520news?sc_lang=zh-HK。
- ^v 参见: <https://www.euronews.com/2021/05/04/eu-suspends-efforts-to-ratify-controversial-investment-deal-with-china>。
- ^{vi} 参见: <https://ctee.com.tw/news/tech/462047.html>。
- ^{vii} 参见: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20210524_21/。
- ^{viii} 参见: <https://www.reuters.com/technology/japan-wants-tsmc-sony-build-20-nanometre-chip-plant-nikkan-kogyo-2021-05-26/>。
- ^{ix} 参见: <https://www.reuters.com/technology/us-chip-funding-could-result-seven-10-new-factories-officials-2021-05-24/>。
- ^x 参见: <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2021/05/statement-us-secretary-commerce-gina-m-raimondo-following-meetings>
- ^{xi} 参见: <https://www.semiconductors.org/robust-federal-incentives-for-domestic-chip-manufacturing-would-create-an-average-of-nearly-200000-american-jobs-annually-as-fabs-are-built-add-nearly-25-billion-annually-to-u-s-economy/>